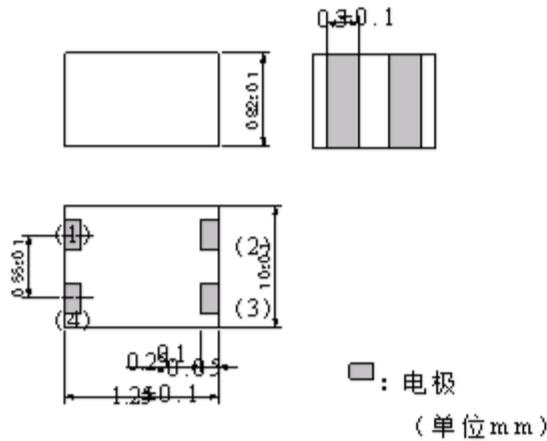


共模扼流线圈 薄膜型

DLP11S / DLP11T 系列 (0504 尺寸)

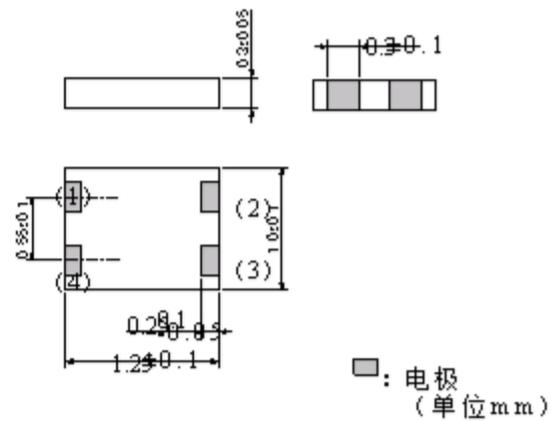
我维度

DLP11S 系列

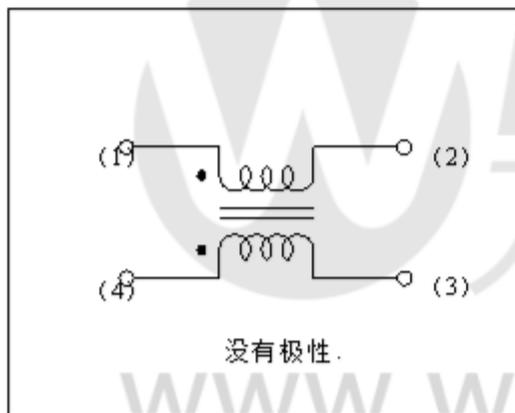


我维度

DLP11T 系列

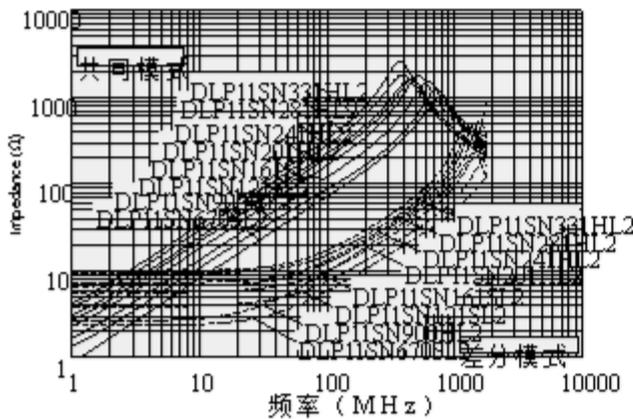


我等效的电路



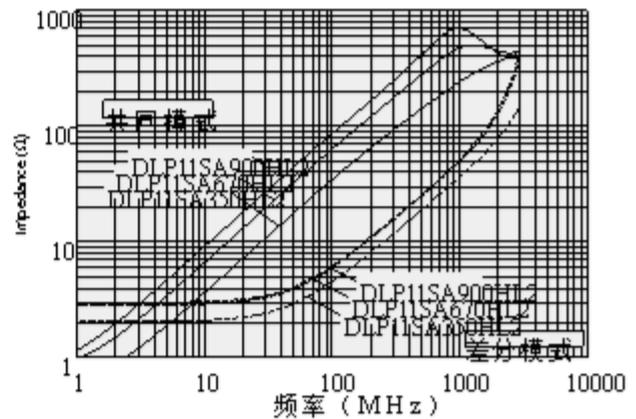
I 阻抗频率特性 (主要项目)

DLP11SN 系列



I 阻抗频率特性 (主要项目)

DLP11SA 系列



在接下来的页面继续.

○ 本数据表适用于用于通用电子设备设计的CHIP COMMON MODE CHOKE COIL.

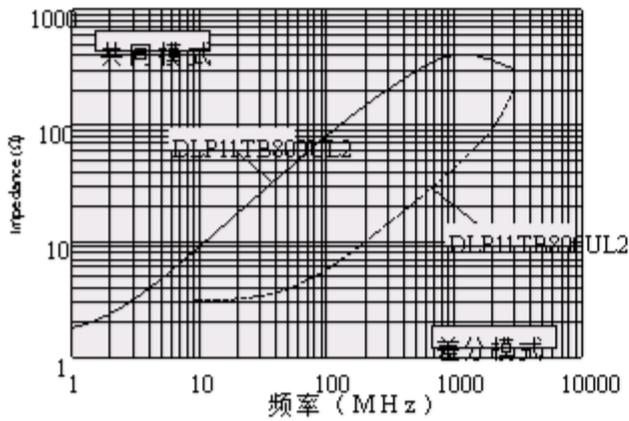
! 注意:

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的, 因此, 它的规格可能会改变或我们的其中的产品可能会在不事先通知的情况下停产. 订购前请咨询我们的销售代表或产品工程师.
2. 此数据表仅有典型规格, 因为没有详细规格的空间. 因此, 请批准我们的产品规格或在订购前处理产品规格的批准单.

☐ 接上页.

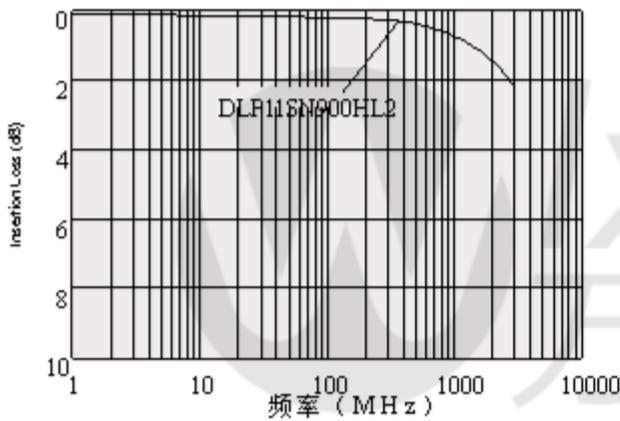
I 阻抗频率特性 (主要项目)

DLP11TB 系列



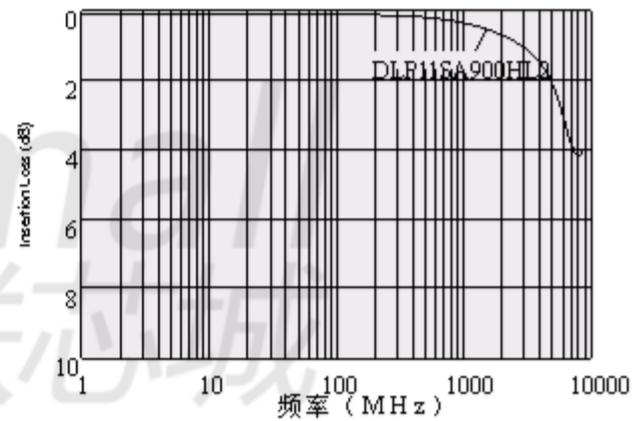
I 差模传输特性 (典型值)

DLP11SN 系列



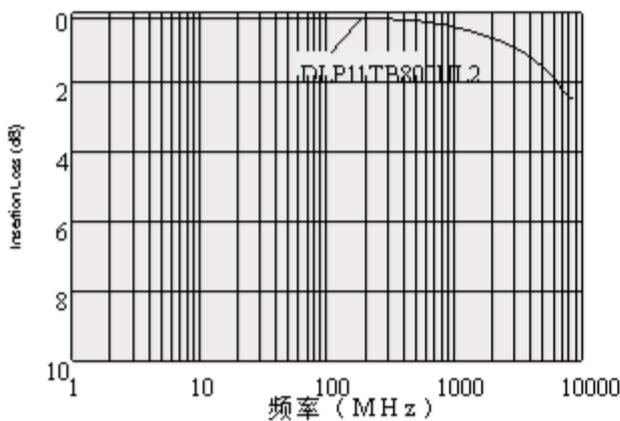
I 差模传输特性 (典型值)

DLP11SA 系列



I 差模传输特性 (典型值)

DLP11TB 系列



我包装

码	打包	最小用量
大号	180mm 压纹胶带	5000 (DLP11T), 3000 (DLP11TB)
乙	散装 (袋)	500

在接下来的页面继续. ☐

○ 本数据表适用于用于通用电子设备设计的CHIP COMMON MODE CHOKE COIL.

! 注意:

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的. 因此, 它的规格可能会改变或我们的其中的产品可能会在不事先通知的情况下停产. 订购前请咨询我们的销售代表或产品工程师.
2. 此数据表仅有典型规格, 因为没有详细规格的空间. 因此, 请批准我们的产品规格或在订购前处理产品规格的批准单.



接上页.
我的额定值 (p: 包装代码)

零件号	共模阻抗 (在100MHz / 20)	额定电流	额定电压	绝缘电阻 (最小值)	耐压	直流电阻	操作 温度范围
DLP11SN670SL2p	67ohm±20%	180毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	1.3ohm±25%	-40到+85
DLP11SN121SL2p	120ohm±20%	140毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	2.0ohm±25%	-40到+85
DLP11SN161SL2p	160ohm±20%	120毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	2.7ohm±25%	-40到+85
DLP11SN900HL2p	90ohm±20%	150毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	1.5ohm±25%	-40到+85
DLP11SN201HL2p	200ohm±20%	110毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	3.1ohm±25%	-40到+85
DLP11SN241HL2p	240ohm±20%	100毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	3.5ohm±25%	-40到+85
DLP11SN281HL2p	280ohm±20%	90毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	4.2ohm±25%	-40到+85
DLP11SN331HL2p	330ohm±20%	80毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	4.9ohm±25%	-40到+85
DLP11SA350HL2p	35ohm±20%	170毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	0.9ohm±25%	-40到+85
DLP11SA670HL2p	67ohm±20%	150毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	1.2ohm±25%	-40到+85
DLP11SA900HL2p	90ohm±20%	150毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	1.4ohm±25%	-40到+85
DLP11TB800UL2p	80ohm±25%	100毫安	5VDC	100M欧姆	12.5VDC	1.5ohm±25%	-40到+85

线路数量: 1

差模到2.5GHz共模转换特性 (Scd21): -40dB (典型值/DLP11TB800UL2)

信号线Z0之间的阻抗特性 (50ps时的TDR): 90欧姆 ±15ohm (DLP11TB800UL2)

我! 小心/通知

! 小心 (等级)

请勿使用额定电流以上的产品
额定电压, 因为这可能会产生过热
并降低绝缘电阻.

注意

镀锡终端芯片的可焊性可能是
低温焊接时的性能恶化
峰值焊料温度低于锡熔点
点被使用. 请确认锡的可焊性
电镀终止芯片使用前.

o 本数据表适用于用于通用电子设备设计的CHIP COMMON MODE CHOKE COIL.

! 注意:

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的. 因此, 它的规格可能会改变或我们的
其中的产品可能会在不事先通知的情况下停产. 订购前请咨询我们的销售代表或产品工程师.
2. 此数据表仅有典型规格, 因为没有详细规格的空间. 因此, 请批准我们的产品
规格或在订购前处理产品规格的批准单.